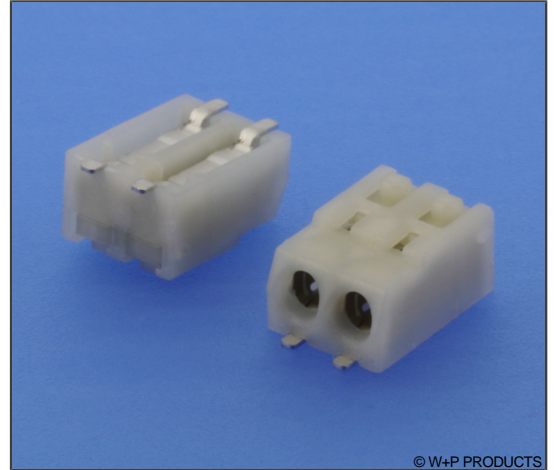
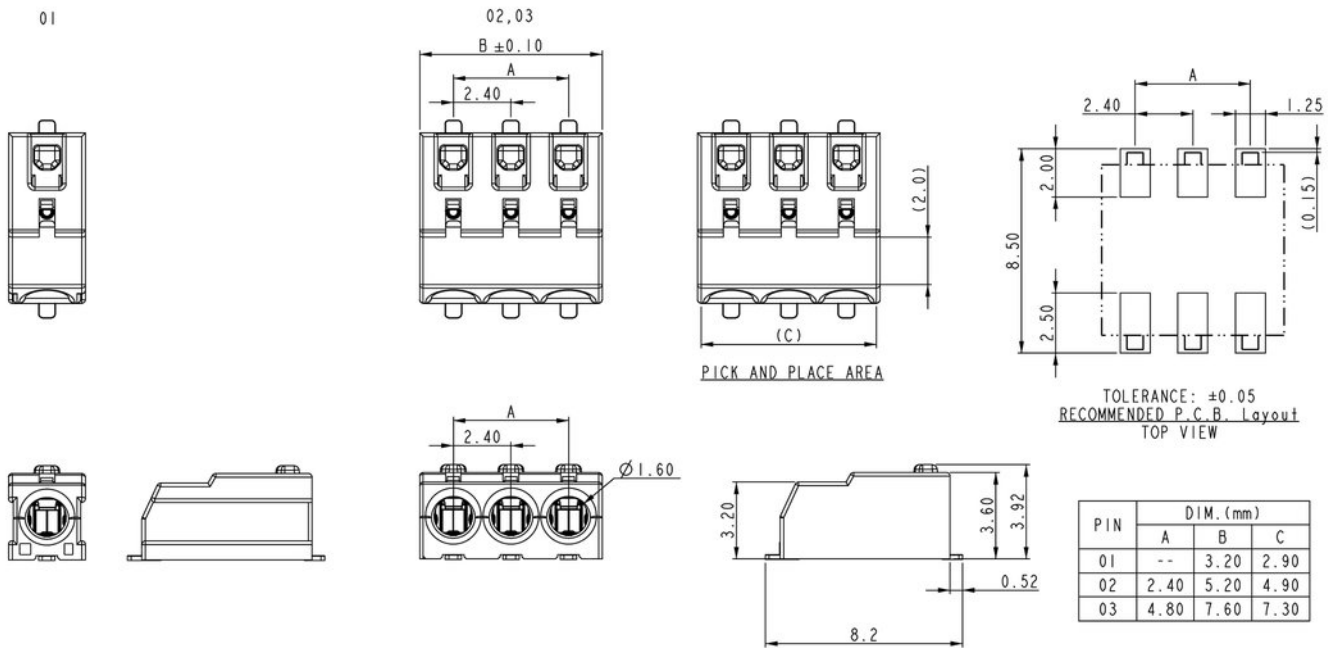


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, UL94 V-0 <i>Thermoplastic, UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung, verzinkt über Nickel <i>Copper alloy, tin plated over nickel</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 26 ~ 22 <i>AWG 26 ~ 22</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>< 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1000 V <i>1000 V</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V <i>250 V</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	4 A (AWG 22) 3 A (AWG 24) 2,5 A (AWG 26) <i>4 A (AWG 22) 3 A (AWG 24) 2.5 A (AWG 26)</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C <i>-40°C ... +105°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	260°C für 10s <i>260°C for 10s</i>



© W+P PRODUCTS



Series	Contacts*	Version	Colour	Plating	Package
5256	03 01-03	2 2 Buchsenkontakt Female	30 30 Weiß White	50 50 Verzinkt Tin plated	TR TR Tape & Reel Tape & Reel

Geeignet für starre Einzeldrahtleiter und verzinnete flexible Leiterlitzen
Suitable for single wire and tinned stranded wire.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren

Fast Profile Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Reflow Soldering Recommendation for shorter peak times

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich T_L	230°C
Verweildauer oberhalb T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 4,5min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Soldering Range Temperature T_L	230°C
Duration above T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1.5°C / s
Peak Temperature T_P	260°C max.
Duration Peak Temperature	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 4.5min

